

苏州德龙激光股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：投2024-005

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	华创证券 中信证券 国泰君安 华安证券 东吴证券 国金证券 平安基金 民生加银基金 山西证券 海通证券 西部证券 新华基金 申万宏源研究 国信弘盛 华福证券	东海证券 逸栩投资 苏州元禾控股股份有限公司 北京金百镭投资管理有限公司 郑州智子投资管理有限公司 广西赢舟管理咨询服务有限公司 北京和聚私募基金管理有限公司 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 乾锦豪(深圳)资产管理有限公司 精砚私募基金管理(广东)有限公司 福州开发区三鑫资产管理有限公司 北京中泽控股集团有限公司 粤佛私募基金管理(武汉)有限公司 上海戊戌资产管理有限公司 上海贵源投资有限公司
时间	2024年8月30日	
地点	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号 德龙激光会议室	
上市公司 接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书 袁凌 证券事务代表 洪叶	

## 投资者关系活动主要内容

### 一、 董事会秘书介绍公司2024年半年度经营情况

2024年半年度公司实现营业收入278,284,769.81元，较上年同期增加34.90%；第二季度营业收入162,626,990.45元，较上年同期增加49.97%；半年度实现归属于上市公司股东的净利润-9,867,879.98元，较上年同期减少-364.85%；半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-16,104,147.04元。

### 二、 问答环节

#### 1、 公司先进封装设备的进展情况如何？

答：公司从2021年开始布局集成电路先进封装应用，如激光开槽（low-k）、晶圆打标等激光精细微加工设备，2023年重点研发出玻璃通孔（TGV）、模组钻孔（TMV）、激光解键合等激光精细微加工设备新产品。公司上半年集成电路先进封装相关设备获得了批量订单，部分新产品尚处于工艺验证阶段。今年上半年公司集成电路先进封装应用相关设备订单同比增长，但因前期基数较小，目前体现在收入端的占比仍较低。

#### 2、 公司半年报中显示人员扩张，公司全年人员扩张趋势是怎样的？

答：公司今年会严格控制人员的扩编，内部各个岗位人员基本已到位，后期如有招聘主要以替换为主。

#### 3、 公司近两年研发费用不断增加，公司半年报公布的在研项目结束后，研发费用是否会回落？

答：公司研发费用主要是研发人员的工资，公司持续在进行新技术新产品的研发，所以研发费用绝对值一般不会减少，但是公司会控制这方面的增速，并且加强研发项目的商业成果转化。

#### 4、 公司钙钛矿产业化进展如何？

答：公司首条钙钛矿薄膜太阳能电池激光加工设备在2022年已交付客户并投入使用，为客户在国内率先实现百兆瓦级规模化量产提供了助力。2022年下半年开始公司启动针对钙钛矿薄膜太阳能电池的新一代生产设备开发工作，对设备的激光器、光学系统、加工幅面和生产效率等都进行了迭代升级，2023年公司已获得大客户GW级产线的部分订单，设备陆续交货

中，除此之外公司一直在积极拓展新客户，从去年开始陆续获得了一些新客户的订单。

#### 5、公司 Micro LED 相关设备进展如何？

答：公司面向Micro LED推出了系列全新解决方案，将为客户产业结构升级提供有力的设备支持：（1）全自动激光剥离：实现从COW到临时基板的剥离；（2）全自动激光巨量转移设备：实现3色芯片的巨量转移，包括COW到基板的直接转移功能；（3）全自动激光巨量焊接设备：实现TFT基板的巨量焊接功能；（4）全自动激光修复设备：实现激光Triming、Pad Cleaning功能；（5）全自动激光焊接设备：实现激光单点的激光焊接功能。

“巨量转移技术”和“巨量检测修复技术”是Micro LED产业化过程中的关键技术。公司已经在相关技术领域做了技术储备，自2022年获得首个客户订单后，公司积极进行产品推广，现已获得多家头部厂商订单。但Micro LED相关产品尚未大批量出货，仍需等待终端产品应用的突破，以推进产业化的爆发。

#### 6、公司碳化硅晶圆切片设备进展如何？

答：公司碳化硅晶圆激光切片设备于2022年完成工艺研发和测试验证，具备8英寸碳化硅晶圆加工能力，2023年取得头部客户批量订单，现阶段该设备已经成功在多家头部碳化硅材料生产企业得到验证和生产使用，成为了碳化硅等新型半导体材料的理想加工解决方案。

附件清单（如有）	无
日期	2024年9月3日